

Pâte thermique GD-3, 150 g, 7,5 W/m²K

Codes produits :

Référence AM9358

EAN13 : -

CUP : 38249996



caractéristiques du produit :

Couleur: Gris

Max. température de fonctionnement:
120 °C

Conductivité thermique: 7,5 W/mK

Attributs du produit :

Description du produit :

La pâte thermoconductrice GD-3 est conçue pour améliorer le transfert de chaleur entre les composants électroniques et les dissipateurs thermiques. Elle est utilisée lors de l'assemblage et de la maintenance des processeurs, des LED, des puces graphiques et autres composants nécessitant la réduction de l'entrefer entre les surfaces de contact. La pâte est conditionnée en godet.

Spécifications techniques

- Type de produit : pâte thermique
- Désignation : GD-3
- Couleur : gris
- Conductivité thermique : 7,5 W/m K
- Densité : 2,5 g/cm³
- Température de fonctionnement : de -35 °C à 120 °C
- Poids du colis : 150 g
- Conditionnement : tasse

Fonctions et caractéristiques

- Comble les micro-irrégularités entre les surfaces adjacentes.
-

- Améliore le transfert de chaleur du composant refroidi vers le dissipateur thermique.
- Conçu pour une utilisation dans les systèmes électroniques et de refroidissement.
- La version grise correspond à la pâte thermique à usage technique.

Idéal pour

- Installation de systèmes de refroidissement sur les processeurs.
- Service et maintenance du système de refroidissement des puces graphiques.
- Applications pour modules LED et éclairage LED avec dissipateur thermique.
- Dispositifs électroniques nécessitant une dissipation thermique efficace.

Contenu de l'emballage

- Pâte thermique GD-3, 150 g

Pourquoi choisir ce produit ?

- Désignation de produit clairement définie GD-3.
- La conductivité thermique indiquée permet une évaluation technique de l'adéquation à une application spécifique.
- L'emballage en gobelet est adapté à une utilisation répétée et à un dosage selon les besoins.
- Conçu pour les applications où il est nécessaire d'assurer le contact entre le composant et le dissipateur thermique.

Instructions d'installation et d'utilisation

- Nettoyer et dégraisser les deux surfaces de contact avant d'appliquer la pâte.
- Appliquez uniquement une fine couche continue entre le composant et le dissipateur thermique.
- N'appliquez pas une couche trop épaisse afin d'éviter une détérioration du transfert de chaleur.
- Après assemblage, assurez-vous que la pression du refroidisseur est uniforme sur la surface de contact.

Avis de sécurité

- À utiliser uniquement pour les interfaces thermiques en électronique.
 - Éviter tout contact avec les yeux, la bouche et la peau en cas de manipulation prolongée.
 - Tenir hors de portée des enfants.
 - Avant toute application sur des appareils électroniques, débranchez
-

l'appareil de la source d'alimentation.

Galerie de produits :